



LINE



LINE



焦點新聞

## 攜手工研院與日本九州大學，聚焦半導體、智慧載具與綠能技術合作



本校與工研院、日本九州大學針對半導體、智慧載具與綠能三大領域簽定合作備忘錄

本校9月7日與工業技術研究院、日本九州大學，針對半導體、智慧載具與綠能三大領域，簽定合作備忘錄，未來將攜手推動三大領域的前瞻技術與人才交流。

2022年開始，本校與工研院、九州大學多次交流與互訪，期間希望能匯集九州學術機構、研究機構技術能量，促成更多臺灣與日本前瞻技術開發、人才交流之機會；直至2023年凝聚共識，進而促成9月7日在「2023國際半導體展」(2023 SEMICON TAIWAN)舉辦簽署儀式。

林奇宏校長表示，陽明交大一直是國內半導體產業的重要推手，也是國內前四所成立培育重點領域產業人才學院的大學；期待未來能有更多國際合作，也有更多海外人士來就讀陽明交大半導體領域相關的國際學程，進一步落實相關研究成果於產業界、注入產業創新技術能量。

九州大學白谷正治副校長也對於本次簽約感到欣喜與支持，他表示，在工研院團隊拜訪九州大學光積體電路實驗室時，特地邀請工研院團隊及臺灣學研機構進行晶片製程、封裝結構與製程設計等議題研究，透過本次簽約，將可以更了解臺灣的未來需求，並強化雙方在半導體產業供應鏈的角色與定位。



林奇宏校長(右起)、工研院胡竹生副院長與九州大學白谷正治副校長，代表三方簽署備忘錄

工研院胡竹生副院長表示，三方MOU鎖定半導體、智慧載具與綠能三個領域，皆為現在各國重點開發的技術領域；尤其在面對氣候變遷所導引之2050淨零碳排的目標，綠能、電動車都是重要關鍵，而半導體是支持所有IC應用領域的技術基盤。陽明交大與九州大學皆有很強的學術研究實力與前瞻技術能量，工研院則擁有應用技術開發與技術產業化能量，三方一起攜手合作，以因應世界在半導體與綠能領域發展趨勢下，彼此合作開發所需前瞻技術及人才交流的方法，以為臺日的產業技術打下基礎。

簽署典禮後亦舉辦「臺日半導體技術國際研討會」，以論壇形式安排Sony半導體製造、三菱電機Power Devices製作所、益芯科技等臺日Tier 1企業，與本校及日本九州大學進行研討，期透過產學研交流瞭解需求與技術優勢，開啟臺日產學研的攜手合作，以培養臺日重點領域所需的專業技術與人才。

← Prev. ≡

訂閱/取消 上期電子報

發行人：林奇宏 總編輯：陳怡如 執行編輯：彭琬玲

網頁維護：創創數位科技 瀏覽人數：**0742590**

Copyright © 2021 National Yang Ming Chiao Tung University All rights reserved

